

目录

第一章 绪论 .....7.....

    一、项目概述.....7.....

    二、项目提出的理由 .....8.....

    三、项目总投资及资金构成 .....8.....

    四、资金筹措方案 .....8.....

    五、项目预期经济效益规划目标.....8.....

    六、项目建设进度规划 .....9.....

    七、环境影响.....9.....

    八、报告编制依据和原则 .....9.....

    九、研究范围.....10.....

    十、研究结论.....10.....

    十一、主要经济指标一览表 .....10.....

        主要经济指标一览表 .....10.....

第二章 行业发展分析 ..... .....

    一、 2025年中国半导体光刻胶市场有望达 100 亿元 .....12.....

    二、晶圆厂扩产是拉动行业增长的重要驱动因素 .....12.....

    三、光刻胶市场结构变化，EUV 增速最快 .....12.....

第三章 项目建设背景、必要性 ..... .....

    一、市场高度集中，长期被日企垄断.....13.....

    二、中国半导体材料市场突飞猛进，光刻胶增长强劲.....13.....

    三、半导体光刻胶是光刻胶重要应用领域之一 .....13.....

四、 项目实施的必要性 .....14.....

第四章 选址方案.....

一、 项目选址原则 .....15.....

二、 建设区基本情况 .....15.....

三、 打造中部地区先进制造业聚集区.....17.....

四、 发掘释放内需潜力，全面融入新发展格局 .....18.....

五、 项目选址综合评价 ..... 20.....

第五章 产品方案分析 .....

一、 建设规模及主要内容.....21.....

二、 产品规划方案及生产纲领.....21.....

产品规划方案一览表 .....21.....

第六章 发展规划.....

一、 公司发展规划 ..... 23.....

二、 保障措施.....26.....

第七章 法人治理.....

一、 股东权利及义务 ..... 28.....

二、 董事.....29.....

三、 高级管理人员 .....32.....

四、 监事.....33.....

第八章 SWOT 分析说明 .....

一、 优势分析（S） .....36.....

二、 劣势分析（W ） ..... 37.....

三、 机会分析（O） ..... 37.....

四、 威胁分析（T） ..... 38.....

第九章 劳动安全.....

一、 编制依据.....41.....

二、 防范措施.....43.....

三、 预期效果评价 ..... 44.....

第十章 环保方案分析 .....

一、 编制依据.....45.....

二、 环境影响合理性分析 ..... 46.....

三、 建设期大气环境影响分析.....46.....

四、 建设期水环境影响分析 ..... 48.....

五、 建设期固体废弃物环境影响分析..... 49.....

六、 建设期声环境影响分析 ..... 49.....

七、 环境管理分析 ..... 49.....

八、 结论及建议..... 50.....

第十一章 节能分析 .....

一、 项目节能概述 ..... 52.....

二、 能源消费种类和数量分析.....53.....

能耗分析一览表..... 53.....

三、 项目节能措施 ..... 53.....

四、 节能综合评价 ..... 55.....

第十二章 进度实施计划

一、项目进度安排

项目实施进度计划一览表

二、项目实施保障措施

56

56

56

第十三章 项目投资分析

一、编制说明

二、建设投资

建筑工程投资一览表

主要设备购置一览表

建设投资估算表

三、建设期利息

建设期利息估算表

固定资产投资估算表

四、流动资金

流动资金估算表

五、项目总投资

总投资及构成一览表

六、资金筹措与投资计划

项目投资计划与资金筹措一览表

58

58

59

60

60

61

61

62

62

62

63

63

64

64

第十四章 项目经济效益评价

一、经济评价财务测算

营业收入、税金及附加和增值税估算表

66

66

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 综合总成本费用估算表 .....       | 67..... |
| 固定资产折旧费估算表 .....       | 67..... |
| 无形资产和其他资产摊销估算表.....    | 68..... |
| 利润及利润分配表.....          | 69..... |
| 二、 项目盈利能力分析 .....      | 69..... |
| 项目投资现金流量表 .....        | 70..... |
| 三、 偿债能力分析 .....        | 71..... |
| 借款还本付息计划表 .....        | 72..... |
| 第十五章 风险分析 .....        |         |
| 一、 项目风险分析 .....        | 73..... |
| 二、 项目风险对策 .....        | 74..... |
| 第十六章 项目总结 .....        |         |
| 第十七章 附表附件 .....        |         |
| 主要经济指标一览表 .....        | 77..... |
| 建设投资估算表.....           | 78..... |
| 建设期利息估算表.....          | 78..... |
| 固定资产投资估算表 .....        | 79..... |
| 流动资金估算表.....           | 79..... |
| 总投资及构成一览表 .....        | 80..... |
| 项目投资计划与资金筹措一览表.....    | 81..... |
| 营业收入、税金及附加和增值税估算表..... | 81..... |
| 综合总成本费用估算表 .....       | 82..... |

固定资产折旧费估算表 .....83.....

无形资产和其他资产摊销估算表.....83.....

利润及利润分配表.....83.....

项目投资现金流量表 .....84.....

借款还本付息计划表 .....85.....

建筑工程投资一览表 .....86.....

项目实施进度计划一览表 .....86.....

主要设备购置一览表 .....87.....

能耗分析一览表.....87.....

# 第一章 绪论

## 一、项目概述

### （一）项目基本情况

- 1、项目名称：岳阳半导体材料项目
- 2、承办单位名称：xxx 投资管理公司
- 3、项目性质：新建
- 4、项目建设地点：xx（待定）
- 5、项目联系人：姚 xx

### （二）主办单位基本情况

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济社会的发展做出了突出贡献。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

### （三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 91.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

#### （四）产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx 吨半导体光刻胶/年。

### 二、项目提出的理由

光刻胶是一种有机化合物，受特定波长光线曝光作用后其化学结构改变，在显影液中的溶解度会发生变化，因此又称光致抗蚀剂。正胶在曝光后发生光化学反应，可以被显影液溶解，留下的薄膜图形与掩膜版相同；而负胶经过曝光后变成不可溶物质，非曝光部分被溶解，获得的图形与掩膜版相反。

### 三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 39257.33 万元，其中：建设投资 31793.76 万元，占项目总投资的 80.99%；建设期利息 701.99 万元，占项目总投资的 1.79%；流动资金 6761.58 万元，占项目总投资的 17.22%。

### 四、资金筹措方案

#### （一）项目资本金筹措方案

项目总投资 39257.33 万元，根据资金筹措方案，xxx 投资管理公司计划自筹资金（资本金）24931.14 万元。

#### （二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 14326.19 万元。

### 五、项目预期经济效益规划目标

- 1、项目达产年预期营业收入（SP）：64300.00 万元。
- 2、年综合总成本费用（TC）：53089.38 万元。
- 3、项目达产年净利润（NP）：8191.33 万元。
- 4、财务内部收益率（FIRR）：14.67%。
- 5、全部投资回收期（Pt）：6.69 年（含建设期 24 个月）。
- 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25226.47 万元（产值）。

## 六、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。

## 七、环境影响

本期工程项目符合当地发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合当地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

## 八、报告编制依据和原则

### （一）编制依据

- 1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
- 2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
- 3、《工业可行性研究编制手册》；
- 4、《现代财务会计》；
- 5、《工业投资项目评价与决策》；
- 6、国家及地方有关政策、法规、规划；
- 7、项目建设地总体规划及控制性详规；
- 8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；

9、国家公布的相关设备及施工标准。

## （二）编制原则

1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方有关规范、标准规定；

2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；

3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；

4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作性；

5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；

6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；

7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

## 九、研究范围

本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。

## 十、研究结论

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

## 十一、主要经济指标一览表

### 主要经济指标一览表

| 序号    | 项目    | 单位   | 指标        | 备注        |
|-------|-------|------|-----------|-----------|
| 1     | 占地面积  | m²   | 60667.00  | 约 91.00 亩 |
| 1.1   | 总建筑面积 | m²   | 116906.55 |           |
| 1.2   | 基底面积  | m²   | 34580.19  |           |
| 1.3   | 投资强度  | 万元/亩 | 347.00    |           |
| 2     | 总投资   | 万元   | 39257.33  |           |
| 2.1   | 建设投资  | 万元   | 31793.76  |           |
| 2.1.1 | 工程费用  | 万元   | 28354.69  |           |
| 2.1.2 | 其他费用  | 万元   | 2593.34   |           |
| 2.1.3 | 预备费   | 万元   | 845.73    |           |
| 2.2   | 建设期利息 | 万元   | 701.99    |           |
| 2.3   | 流动资金  | 万元   | 6761.58   |           |
| 3     | 资金筹措  | 万元   | 39257.33  |           |
| 3.1   | 自筹资金  | 万元   | 24931.14  |           |
| 3.2   | 银行贷款  | 万元   | 14326.19  |           |
| 4     | 营业收入  | 万元   | 64300.00  | 正常运营年份    |
| 5     | 总成本费用 | 万元   | 53089.38  | ""        |
| 6     | 利润总额  | 万元   | 10921.78  | ""        |
| 7     | 净利润   | 万元   | 8191.33   | ""        |
| 8     | 所得税   | 万元   | 2730.45   | ""        |
| 9     | 增值税   | 万元   | 2406.98   | ""        |
| 10    | 税金及附加 | 万元   | 288.84    | ""        |
| 11    | 纳税总额  | 万元   | 5426.27   | ""        |
| 12    | 工业增加值 | 万元   | 19182.90  | ""        |
| 13    | 盈亏平衡点 | 万元   | 25226.47  | 产值        |
| 14    | 回收期   | 年    | 6.69      |           |
| 15    | 内部收益率 |      | 14.67%    | 所得税后      |
| 16    | 财务净现值 | 万元   | 2378.15   | 所得税后      |

## 第二章 行业发展分析

### 一、2025 年中国半导体光刻胶市场有望达 100 亿元

据 TECHCET 预测，2021 年全球半导体光刻胶市场规模将同比增长 11%，达到 19 亿美元。在全球缺货的大环境下，芯片制造，尤其是晶圆代工产能供不应求为半导体光刻胶提供了持久的增长动力。未来几年，全球半导体光刻胶市场将保持稳定的增长。

据 SEMI 数据显示，中国光刻胶半导体市场规模从 2015 年的 1.3 亿美元增长至 2020 年的 3.5 亿美元。随着国内晶圆代工产能的不断提升，2025 年中国光刻胶半导体市场规模有望达到 100 亿元，2020-2025 年年复合增速将达到 35%，明显高于全球市场增速。

### 二、晶圆厂扩产是拉动行业增长的重要驱动因素

EMI 的数据显示，2017-2020 年间全球投产的半导体晶圆厂为 62 座，其中有 26 座设于中国大陆，占全球总数的 42%。预计从 2020 年到 2024 年至少新增 38 个 12 英寸晶圆厂，其中中国将新建 19 座（中国台湾 11 座，中国大陆 8 座）。8 吋晶圆月产能至 2024 年也将达 660 万片规模。光刻胶等半导体材料供应商将有望受益于扩产浪潮。

### 三、光刻胶市场结构变化，EUV 增速最快

全球半导体光刻胶市场呈结构性增长，据 TECHCET 数据显示，2020 年和 2021 年，用于 KrF 和 ArFi 的光刻胶市场较高，而 EUV 的应用范围正在从逻辑芯片扩展到 DRAM，预计 2021 年 EUV 光刻胶市场超过 2000 万美元，到 2025 年将超过 2 亿美元，年复合增速超过 50%。然而目前，EUV 光刻胶的市场几乎被日本的 TOK、信越化学和 JSR 三分天下。

## 第三章 项目建设背景、必要性

### 一、市场高度集中，长期被日企垄断

全球光刻胶市场长期被日美高度垄断，数据显示，日本的合成橡胶（JSR）、东京应化（TOK）位居一二，CR5 高达 87%。

在半导体光刻胶领域，日本企业依然占据领先地位，实现了对半导体光刻胶的垄断。前五中除了美国杜邦，其余四家均为日本企业。其中 JSR、TOK 的产品可以覆盖所有半导体光刻胶的品种，是绝对的龙头，尤其在高端的 EUV 市场高度垄断。目前国内市场仍主要以 PCB 用光刻胶供应为主，面板、半导体用光刻胶自给率依然很低。

### 二、中国半导体材料市场突飞猛进，光刻胶增长强劲

半导体材料分为前道晶圆制造材料和后道封装材料两类，以前者为主，主要包括硅片、光刻胶、掩膜版、溅射靶材、电子特气、湿电子化学品、CMP 抛光材料等。根据 SEMI 的数据，2020 年，全球半导体材料市场规模增长至 553.1 亿美元，其中晶圆制造材料为 349 亿美元；中国大陆市场规模快速增长至 97.6 亿美元，首次成为全球第二大市场，增速 12%，增幅跃居全球第一。

在晶圆制造材料细分市场中，增长最为强劲的是光刻胶和光刻胶配套材料、湿化学品以及 CMP 抛光材料。据统计，光刻胶和光刻胶配套试剂分别占晶圆制造材料市场的 6%和 8%。

### 三、半导体光刻胶是光刻胶重要应用领域之一

光刻胶按照下游应用领域划分，主要可分为 PCB、面板、半导体三类，每一类光刻胶又有各自细分品类。其中半导体光刻胶技术门槛最高，按照光源波长的从大到小，可分为紫外宽谱（300-450nm）、g 线（436nm）、i 线（365nm）、KrF（248nm）、ArF（193nm）、EUV（13.5nm）等主要品类，每一种品类的组分、适用的 IC 制程技术节点也不尽相同。

## 四、项目实施的必要性

### （一）提升公司核心竞争力

项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。

## 第四章 选址方案

### 一、项目选址原则

项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。

### 二、建设区基本情况

岳阳，古称“巴陵”，又名“岳州”，湖南省地级市，省域副中心城市，第二大经济体，首批沿江开放城市，长江中游重要的区域中心城市，湖南省大城市，湖南自贸。建城始于公元前 505 年，因原郡治位于天岳幕阜山之南而得名，是一座有着 2500 多年悠久历史的文化名城。位于湖南省东北部，北枕长江，南纳三湘四水，怀抱洞庭，江湖交汇，行政区域面积 14858 平方千米。根据第七次人口普查数据，岳阳市常住人口为 5051922 人。岳阳交通极为便利，长江、京广铁路、浩吉铁路、京广高铁、京港澳高速公路、杭瑞高速公路等国家交通主动脉在市区交织成网。岳阳是湖南唯一的国际贸易口岸城市，也是中国著名的港口城市。城陵矶港通江达海，设有城陵矶综合保税区。2018 年 12 月 26 日岳阳三荷机场正式通航，该市形成水陆空铁四位一体综合性大交通格局。岳阳人文深厚、风景秀丽，集名山、名水、名楼、名人、名文于一体，是中华文化重要的始源地之一，亦是海内外闻名的旅游胜地。2014 年岳阳获评中国最具幸福感和最具文化软实力之城，是全国唯一获取两项殊荣的地级市。2015 年，岳阳荣膺“中国十大活力休闲城市”。2015 年，岳阳获得“全国文明城市”称号。2019 年，岳阳位列中国地级市百强第 37 名。2020 年 6 月，经中央依法治国委入选为第一批全国法治政府建设示范地区和项目名单。2020 年 7 月，全国爱卫会确认岳阳市城市为国家卫生城市。

“十四五”时期，我市发展环境面临深刻复杂变化，机遇与挑战

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/408032040021007045>